**AI驅動下的半導體產業創新與挑戰**

* **指導單位：經濟部產業發展署**
* **主辦單位：****資訊工業策進會、TEEMA 台灣區電機電子工業同業公會**
* **協辦單位：中華系統性創新學會、國際創新方法學會、國立清華大學工業工程與工程管理學系**

本次論壇以「AI 驅動下的半導體產業創新與挑戰」為主題，邀請來自產業界與學術界的專家齊聚一堂，**探討 AI 技術在半導體產業的未來格局，並剖析技術創新演進所帶來的機會與挑戰。**透過前瞻觀點與實務分享，期望為業界提供具啟發性與創新性的對策，共同加速產業升級，提升競爭優勢。

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **講題：先進封裝-引領工業革新的浪潮** | 講題： |
| **王愉博 副總,****矽品精密工業股份有限公司****研發中心** | **黃俊杰 副教授,****國立雲林科技大學****電子工程系** |

**📅 會議時間：2025/6/26 (週四 下午13:30~16:30)**

**📍 會議地點：國立清華大學 工程一館 演講廳 (新竹市東區光復路二段101號)**

**🔗 報名連結： xxx**

**✨ 歡迎報名參加，全程免費參加，本活動現場座位有限，請盡早報名。**

**※注意事項：**

**本活動現場座位有限，完成報名後，另行寄發報到通知信。**

**若有相關活動異動將以電子郵件方式寄送通知。**

**如有任何問題，請來信詢問：service@ssi.org.tw (中華系統性創新學會, 電話03-5723200)**